

HiPerFET™ Power MOSFETs

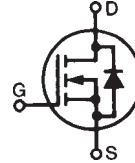
IXFA 3N120
IXFP 3N120

$$\begin{aligned} V_{DSS} &= 1200 \text{ V} \\ I_{D25} &= 3 \text{ A} \\ R_{DS(on)} &= 4.5 \Omega \end{aligned}$$

$$t_{rr} \leq 300 \text{ ns}$$

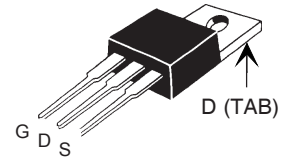
N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated, Low Q_g , High dv/dt

Preliminary Data Sheet

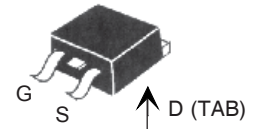


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	1200	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	1200	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	3	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	12	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	3	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	20	mJ
E_{AS}		700	mJ
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 4.7 \Omega$	10	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	200	W
T_J		-55 to +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 to +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.063 in) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (TO-220)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-220	4	g
	TO-263	2	g

TO-220 (IXFP)



TO-263 (IXFA)



G = Gate D = Drain
S = Source TAB = Drain

Features

- Low gate charge and capacitances
 - easier to drive
 - faster switching
- International standard packages
- Low $R_{DS(on)}$
- Rated for unclamped Inductive load Switching (UIS)
- Molding epoxies meet UL 94 V-0 flammability classification

Advantages

- Easy to mount
- Space savings
- High power density

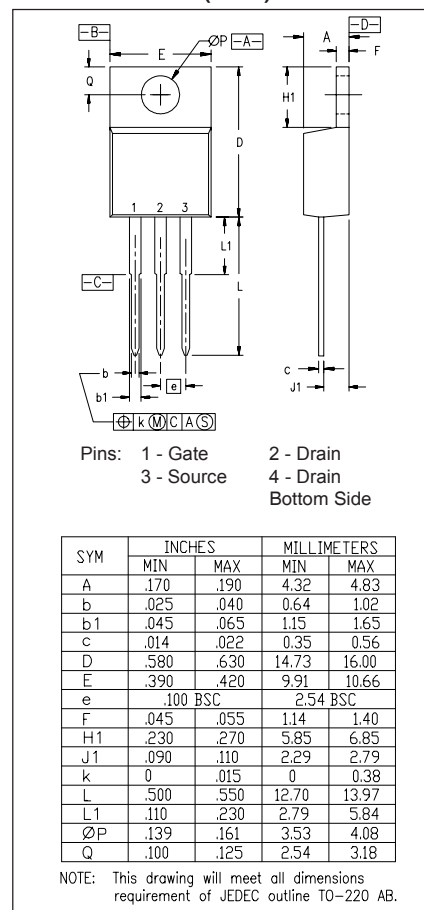
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 1 \text{ mA}$	1200		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 1.5 \text{ mA}$	2.5		5.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0 \text{ V}$			50 μA 2 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2 \%$			4.5 Ω

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$V_{DS} = 20\text{ V}; I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, pulse test	1.5	2.5	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		1050	pF
C_{oss}			100	pF
C_{rss}			25	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 4.7\ \Omega$ (External),		17	ns
t_r			15	ns
$t_{d(off)}$			32	ns
t_f			18	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		39	nC
Q_{gs}			9	nC
Q_{gd}			22	nC
R_{thJC}	(TO-220)		0.62	K/W
R_{thCK}			0.25	K/W

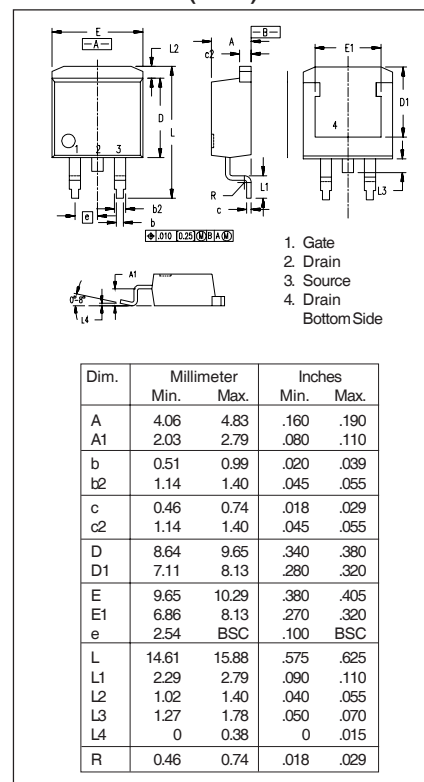
Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$			3 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}			12 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			1.5 V
t_{rr}	$I_F = I_S, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{ V}$		0.4	300 ns
Q_{RM}			1.2	μC
I_{RM}				A

TO-220 (IXFP) Outline



TO-263 (IXFA) Outline



IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	

Fig. 1. Output Characteristics
@ 25 Deg. C

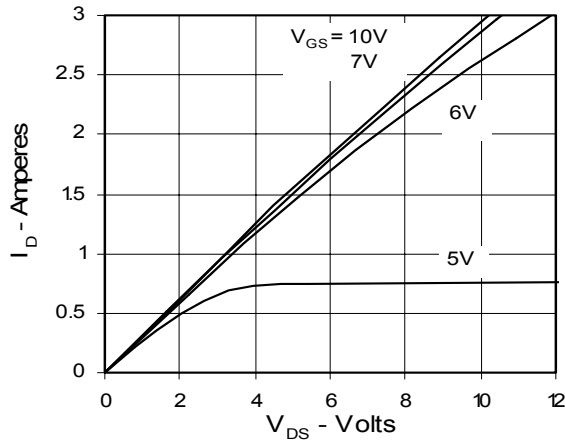


Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25 deg. C

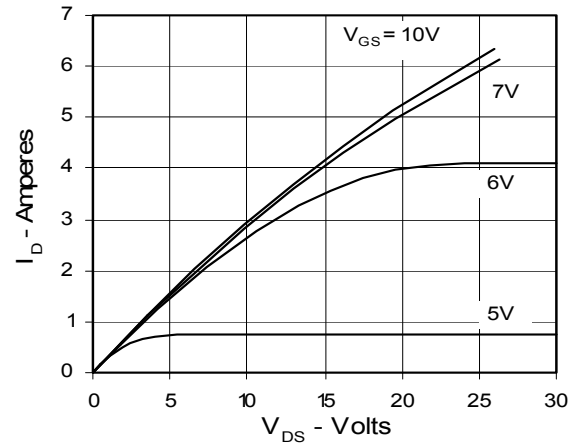


Fig. 3. Output Characteristics
@ 125 Deg. C

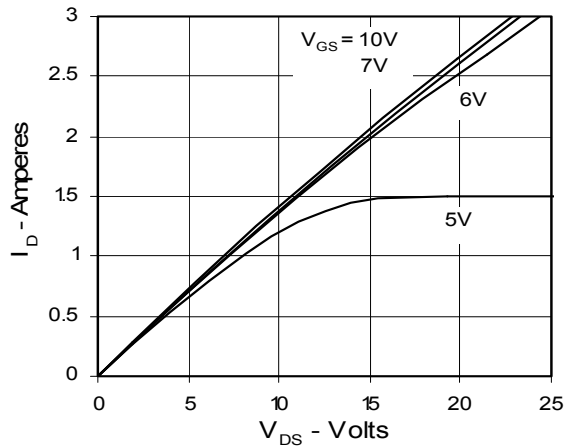


Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25} Value vs. Junction Temperature

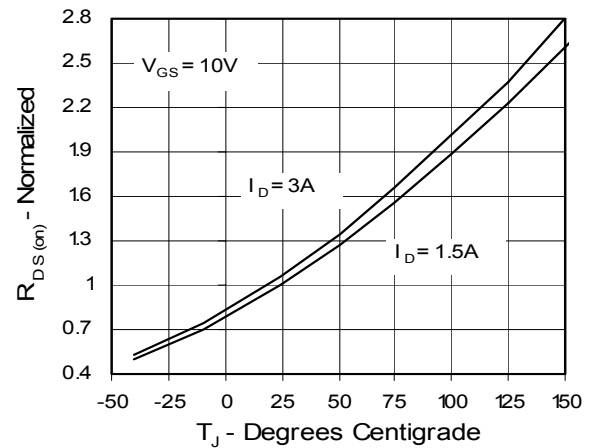


Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25} Value vs. I_D

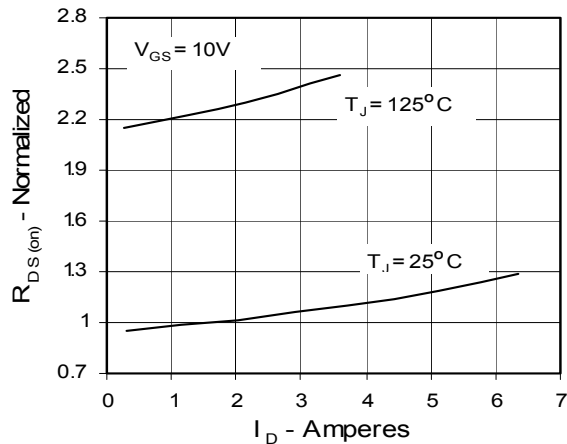


Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature

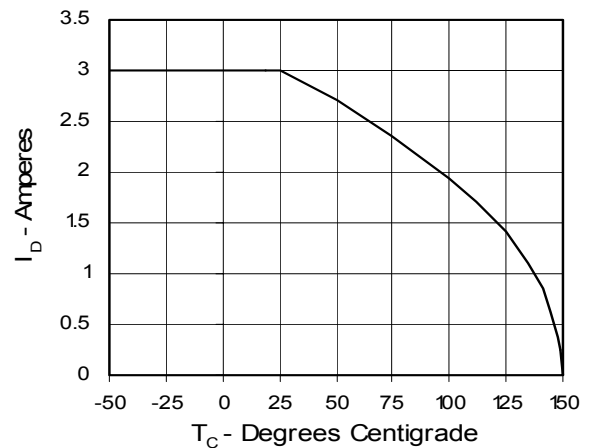


Fig. 7. Input Admittance

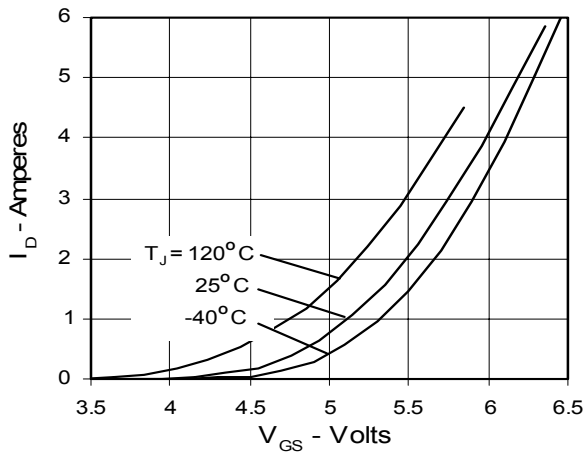


Fig. 8. Transconductance

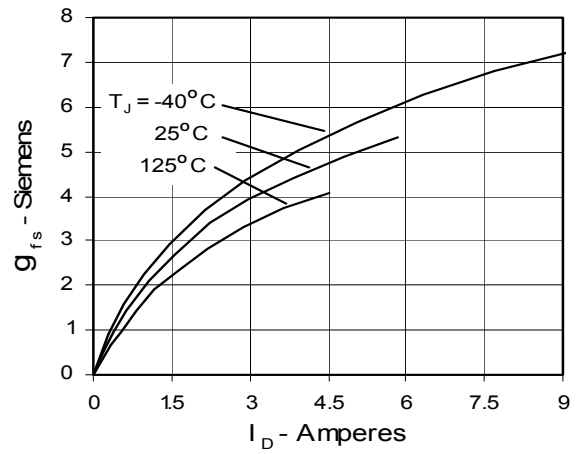


Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage

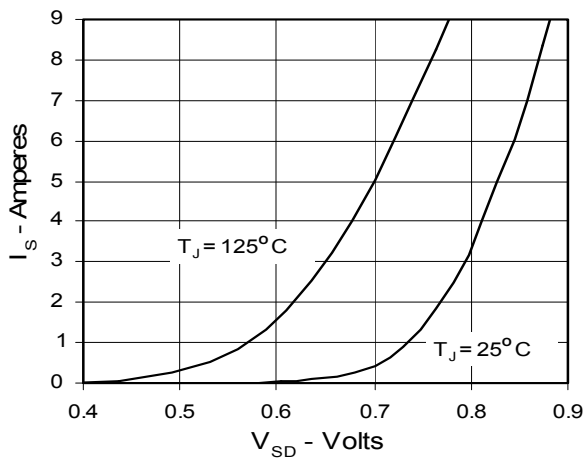


Fig. 10. Gate Charge

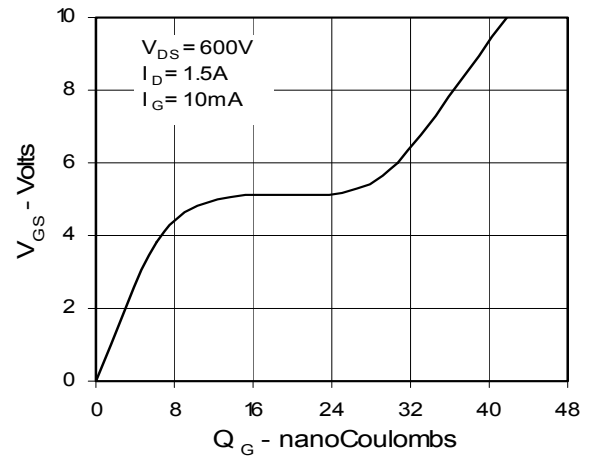


Fig. 11. Capacitance

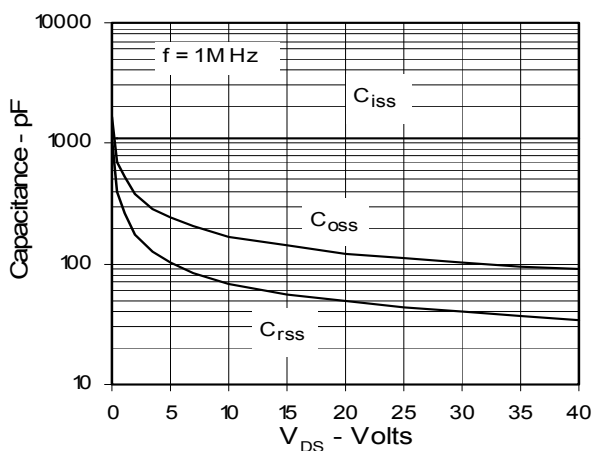
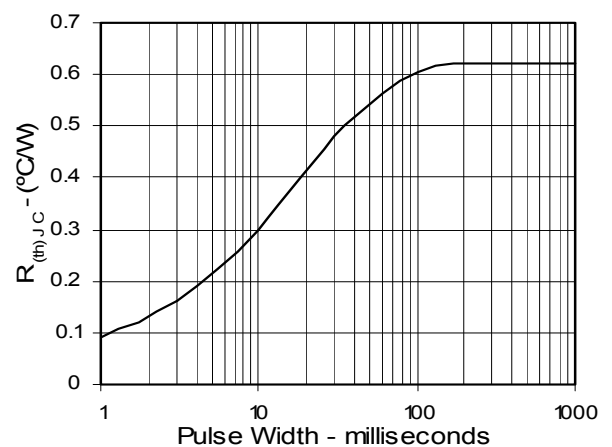


Fig. 12. Maximum Transient Thermal Resistance





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.